



PANEL THERMOCHIP

TIPO DE PANEL	e total (mm)	RT (m2K/W)	U (W/m2K)	Peso (kg/m2)	Peso (kg/panel)	*3 apoyos L=1220	
						Carga max. (kg/m2)	Carga a L=200 (kg/m2)
TDMH/10-40-19_XPS 40mm	69	1,41	0,71	19,98	29,25	900,00	216,00
TDMH/10-50-19_XPS 50mm	79	1,72	0,58	20,30	29,72	1025,00	246,00
TDMH/10-60-19_XPS 60mm	89	1,92	0,52	20,62	30,19	1162,00	266,00
TDMH/10-80-19_XPS 80mm	109	2,49	0,40	21,26	31,12	1327,00	319,00
TDMH/10-100-19_XPS 100mm	129	2,90	0,34	21,90	32,06	1573,00	378,00
TDMH/10-120-19_XPS 120mm	149	3,63	0,28	22,54	33,00	1763,00	423,00
TDMH/10-140-19_XPS 140mm	169	4,20	0,24	23,18	33,94	1931,00	464,00
TDMH/10-160-19_XPS 160mm	189	4,77	0,21	23,82	34,87	>1931,00	>464,00
TDMH/10-200-19_XPS 200mm	229	5,61	0,18	25,01	36,61	>1931,00	>464,00

*Resistencia mecánica, cargas positivas en apoyos. L en mm

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tablero exterior - Aglomerado hidrófugo

Espesor	e (mm)	19
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,13
Densidad	D (kg/m3)	600
Difusión al vapor de agua	μ	20
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1700

Núcleo aislante - XPS

Espesor	e (mm)	40	50	60	80	100	120	140	160	200
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,033	0,033	0,035	0,035	0,037	0,035	0,035	0,035	0,037
Densidad	D (kg/m3)	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Difusión al vapor de agua	μ	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1.450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450

Tablero interior - DM

Espesor	e (mm)	10
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,18
Densidad	D (kg/m3)	730
Difusión al vapor de agua	μ	20
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1700